



TUGAS AKHIR

**Pengaruh Waktu *Reflow* terhadap  
Lapisan *Intermetallic Compound* (IMC)  
pada Antarmuka Sambungan Solder  
96.5wt%Sn-3wt%Ag-0.5wt%Cu  
(SAC305) dan Substrat Cu**

Zulfa Fakhrina  
NIM. 06171079

Andromeda Dwi Laksono, S.T., M.Sc.  
Hizkia Alpha Dewanto, S.T., M.Sc.

Program Studi Teknik Material dan Metalurgi  
Jurusan Ilmu Kebumihan dan Lingkungan  
Institut Teknologi Kalimantan  
Balikpapan, 2021



TUGAS AKHIR

**Pengaruh Waktu *Reflow* terhadap  
Lapisan *Intermetallic Compound* (IMC)  
pada Antarmuka Sambungan Solder  
96.5wt%Sn-3wt%Ag-0.5wt%Cu  
(SAC305) dan Substrat Cu**

Zulfa Fakhrina  
NIM. 06171079

Andromeda Dwi Laksono, S.T., M.Sc.  
Hizkia Alpha Dewanto, S.T., M.Sc.

Program Studi Teknik Material dan Metalurgi  
Jurusan Ilmu Kebumihan dan Lingkungan  
Institut Teknologi Kalimantan  
Balikpapan, 2021